

证券代码：002475

证券简称：立讯精密

公告编号：2024-069

立讯精密工业股份有限公司

关于拟注册发行银行间债券市场

非金融企业债务融资工具(DFI)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，保障持续健康发展的资金需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业超短期融资券业务指引》《非金融企业中期票据业务指引》等有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币120亿元（含120亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的债务融资工具品种。本次注册发行具体情况如下：

一、本次拟注册发行债务融资工具（DFI）的具体方案

- 发行人：立讯精密工业股份有限公司，公司非失信责任主体；
- 发行品种：包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等；
- 注册发行规模及期限：DFI注册阶段可不设置注册额度，本次注册顺利获批后，公司将根据实际经营情况，确定每期发行品种、额度和期限等，DFI项下各类债券规模余额合计不超过人民币120亿元（含120亿元），并在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行；

4、发行利率：发行利率根据发行时市场情况，通过簿记建档、集中配售方式最终确定；

5、注册有效期：取得中国银行间市场交易商协会同意注册批文之日起2年内有效；

6、发行时间：公司将在注册额度有效期内根据实际资金需求情况和发行市场情况，择机一次性发行或分期发行；

7、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）；

8、发行方式：本次发行债务融资工具（DFI）由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

9、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本债券；

10、募集资金用途：本次注册发行债务融资工具（DFI）募集资金用于发行人本部及下属公司偿还金融机构借款、补充营运资金、偿还信用债券等交易商协会认可的用途；

11、决议有效期：自公司股东会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

二、董事会提请股东会授权事项

根据公司本次注册发行的安排，为高效、有序地完成公司本次注册发行工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事长根据公司资金需要、业务情况以及市场条件全权决定和办理与本次债务融资工具（DFI）注册、发行有关的具体事宜，主要包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，决定或修订、调整本次发行债务融资工具（DFI）的发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与本次发行债务融资工具（DFI）相关的具体事宜；

2、聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

3、签署与本次债务融资工具（DFI）注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书和承销协议等；

4、办理与本次债务融资工具（DFI）注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理本次债务融资工具（DFI）的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；

5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行债务融资工具（DFI）的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；

6、办理与本次发行债务融资工具（DFI）有关的其他事项；

7、本次授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行债务融资工具的审批程序

本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间将另行通知。

四、风险提示

公司债务融资工具（DFI）的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。本次申请发行债务融资工具（DFI）的事项是否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本次注册发行的最终注册发行方案，需以交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年8月23日